



挤出用 无规共聚

YUHWA POLYPRO RJ6308

特性及用途

物性

产品的类别	挤出用 无规共聚		
特点	超高纯度, 高透明性, 抗冲击性		
应用实例	半导体 Wafer Carrier Box		
项目	代表值	单位	测试办法
熔融指数 Melt Index	10	g/10min.	ASTM D1238
密度 Density	0.9	g/cm ³	ASTM D1505
抗张强度(屈服点) Tensile Strength at Yield	300	kgf/cm ²	ASTM D638
拉伸率 Elongation at Break	>500	%	ASTM D638
弯曲弹性模量 Flexural Modulus	11,500	kgf/cm ²	ASTM D790
硬度 Hardness (Rockwell)	87	R Scale	ASTM D785
冲击强度 Impact Strength (Izod with Notch)	6	kgf cm/cm	ASTM D256
熔点 Melting Point	145	°C	ASTM D3418

